# **YDIV33-0208SC1**



2-8GHz功分器 数据手册

四川益丰电子科技有限公司

Sichuan YiFeng Electronic Science & Technology Co., LTD

#### 产品简介

YDIV33-0208SC1 型 GaAs 单片集成 0 度功分器, 在 2~8GHz 的频率范围具有较低的插损和优良的端口驻波 特性,隔离度大于16dB,非常适合应用于微波混合集 成电路和多芯片模块。

该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好接地,不需 要额外的接地措施,使用简单方便。芯片背面进行了金 属化处理,适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

### 关键技术指标

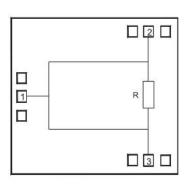
工作频段: 2 to 8 GHz

插入损耗: ≤0.9dB

芯片尺寸: 1.4mm x 0.8mm

#### 应用领域

- 微波无线电
- 测试测量
- RF/微波电路
- 仪器仪表
- 军事和航天



YDIV33-0208SC1 功能框图



电话: 028 61962718 & 61962728 四川益丰电子科技有限公司 邮箱: sales@yifengelectronics.com 传真: 028 61962738 网址: www.yifengelectronics.com

邮箱: sales@yifengelectronics.com

网址: www.yifengelectronics.com



# 极限参数

储存温度	-65 ~ +150°C
工作温度	-55 ~ +125℃
结温	175℃
静电防护等级(HBM)	Class1C

注意: 高功率应用时,请采用共晶烧结工艺安装芯片。

# **电性能表** (TA=+25℃, 50 system)

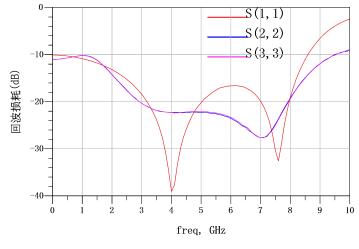
指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围		2-8		GHz
输入驻波	-	1.7	-	-
输出驻波	-	1.5	-	-
插入损耗	-	1.1	-	dB
隔离度	-	16	-	dB

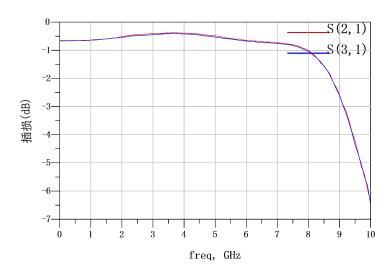
# YDIV33-0208SC1

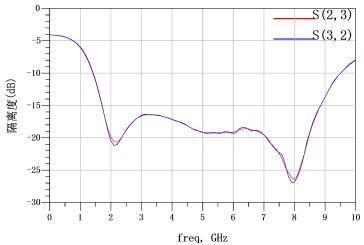




# 测试曲线







# 键合压点定义

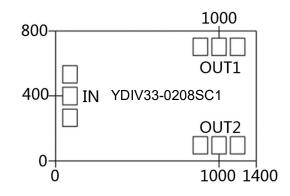
压点编号	功能符号	功能描述
1	IN	RF 输入端口,阻抗 50
2、3	OUT1, OUT2	RF 输出端口,阻抗 50
	GND	芯片背面必须接地

邮箱: sales@yifengelectronics.com 网址: www.yifengelectronics.com

# YDIV33-0208SC1



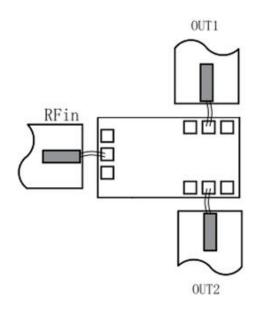
#### 外形尺寸



#### 说明:

- 1. 单位: 微米
- 2. 芯片背面镀金
- 3. 芯片背面接地
- 4. 键合压点镀金,压点尺寸: 100x100 (um)
- 5. 不能在通孔上进行键合
- 6. 外形尺寸公差: ±50um

#### 推荐装配图



邮箱: sales@yifengelectronics.com

网址: <u>www.yifengelectronics.com</u>